

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年3月21日(2013.3.21)

【公表番号】特表2010-518649(P2010-518649A)

【公表日】平成22年5月27日(2010.5.27)

【年通号数】公開・登録公報2010-021

【出願番号】特願2009-549743(P2009-549743)

【国際特許分類】

H 05 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 05 K 3/46 L

【誤訳訂正書】

【提出日】平成25年2月1日(2013.2.1)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0027

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0027】

接着層15によって形成された接着によって、回路基板のリジッド部1を回路基板のフレキシブル部7に接続した後、16で示されるような分割が、フレキシブル部7とは反対側を向くリジッド部1の端面から出発して予め形成されたミリング端14の領域で実行され、その結果、回路基板の本来的にモノリシック構造のリジッド部1の、従って分離されたサブポーションまたは部分領域17、18が、フレキシブル部7を介して接続される。